

開発設計者のための CAE による接合・剥離評価技術セミナー ～自動車・半導体分野の技術動向や事例を紹介～

サイバネットシステム(株)

https://www.cybernet.co.jp/ansys/seminar_event/event/bondingpeeling_20241029/

2024 年 10 月 29 日(火)

13:40～14:30 基調講演 「接着接合の基礎と強度・寿命評価法および最近の動向」

鈴木 靖昭

部材接合方法の 1 つである接着剤を用いた接着接合は異材接合・応力分散性・軽量化などの面でメリットがある一方で、接合力と耐久性の確保の為に表面処理や形状に留意する他、適切な評価・予測手法を用いることが重要である。

本講演では接着接合における接合力向上の手段や耐久性予測の手法を紹介すると共に、最近の接着接合技術の動向についても紹介する。

戻る <http://www.s-adhesion-tech.com/seminarkouen.html>